

2023 TAIWAN BUSINESS ALLIANCE

臺灣 全球招商論壇 CONFERENCE

2023年11月27日
星期一 14:00~16:30

南港展覽館二館7樓E、F會議室
台北市南港區經貿二路2號7樓



活動網站

- 參加方式：免費活動(請務必攜帶名片)
- 洽詢專線：+886-7-6955298分機204高先生 / 分機276周先生
- 報名方式：(1)線上報名：<https://inves-taiwan.com/event/9IQ5B0EDD1S4>
(2)電子郵件：jeance@mail.mirdc.org.tw / ntou0810@mail.mirdc.org.tw
(3)傳真報名：+886-7-6955627
- 報名截止時間：2023年11月20日(一)18時或額滿為止
- 本論壇以英文進行，會場備有中英文同步口譯

論壇活動摘要

■ 投資意向書(LOI)簽署

集結未來三至五年對臺投資之外商與經濟部聯合簽署投資意向書，展現臺灣投資環境之信心。

■ 頒發外商感謝獎座

頒贈感謝獎座予持續加碼投資臺灣及關鍵技術引進之外商，感謝協力帶動臺灣經濟成長及產業國際接軌之關鍵角色。

■ 主題演講及座談

AI的興起，從晶圓代工、半導體封裝、散熱、系統組裝等供應鏈，都將雨露均霑。本論壇將邀請專家學者及跨國企業代表，進一步探討AI科技浪潮與供應鏈重組下，臺灣軟硬體產業之投資機會，以達共創商機目的。

議程表

13:00~14:00	報到
14:00~14:10	開幕致詞 王美花 / 經濟部 部長
14:10~14:20	貴賓致詞 府院高層
14:20~14:40	頒發「外商感謝獎座」暨合影、簽署投資意向書(LOI)業者合影 府院高層
14:40~14:55	藝文演出
14:55~15:10	投資意向書(LOI)換約儀式 王美花 / 經濟部 部長
15:10~15:30	中場休息
15:30~15:50	專題演講 / AI發展的現況與未來 花凱龍 / 台灣微軟 首席技術長
15:50~16:30	座談 / 全球供應鏈重組趨勢，臺灣之優勢與機會 主持人：曹世綸 / SEMI 國際半導體產業協會 全球行銷長暨台灣區總裁 與談人：文曉安 / 巴斯夫電子材料事業處 全球生產營運副總裁 李俊隆 / 台灣默克集團 董事長 吳東嶸 / 優貝克科技 執行副總經理

會議結束

※主辦單位保留議程主題及講者異動之權利